



# UNIVERSITÀ DI PISA

---

## TECNOLOGIE MICROELETTRONICHE

**FRANCESCO PIERI**

Anno accademico 2019/20  
CdS INGEGNERIA ELETTRONICA  
Codice 318II  
CFU 6

Moduli	Settore/i	Tipo	Ore	Docente/i
TECNOLOGIE MICROELETTRONICHE	ING-INF/01	LEZIONI	60	FRANCESCO PIERI

### Obiettivi di apprendimento

#### *Conoscenze*

Gli studenti che hanno superato il corso hanno una conoscenza generale delle tecniche utilizzate nella fabbricazione dei circuiti integrati (IC) e sono in grado di descrivere in dettaglio la sequenza di fabbricazione di un circuito CMOS. Conoscono la fisica dei processi di fabbricazione più comuni (deposizione di film sottili, litografia UV, attacco, etc.), la struttura e funzionamento delle relative apparecchiature. Conoscono alcune delle tecniche di caratterizzazione utilizzate nell'industria microelettronica.

#### *Modalità di verifica delle conoscenze*

Nell'esame finale agli studenti è richiesto di presentare, in forma chiara ed organizzata, gli aspetti fisico-chimici e tecnologici dei più importanti processi di fabbricazione dei circuiti integrati, esponendo le opzioni disponibili ad un ingegnere di processo e come ogni scelta tecnica possa impattare le caratteristiche del circuito fabbricato.

Modalità di verifica:

- esame finale orale

#### *Capacità*

Gli studenti che hanno superato il corso sono in grado di valutare l'impatto di ciascun passo di processo di una sequenza di fabbricazione di IC sulle caratteristiche finali del dispositivo. Sanno confrontare le differenti opzioni tecniche disponibili per ciascun processo e valutare la più adatta in termini di complessità, compatibilità e risultati desiderati. Per ciascun passo di processo, sono in grado di prevedere come la modifica di una variabile di processo ne cambia le prestazioni. Sanno come progettare i parametri di un processo (ossidazione termica, diffusione, impiantazione ionica, etc) in modo da ottenere specifiche predeterminate (spessori, resistenze di strato, profondità di giunzione, etc.)

#### *Modalità di verifica delle capacità*

Le capacità acquisite vengono verificate durante l'esame orale finale (vedi anche "Modalità di verifica delle conoscenze"), anche mediante la proposta di semplici esercizi quantitativi.

Modalità di verifica:

- esame finale orale

#### *Prerequisiti (conoscenze iniziali)*

Elementi di fisica dei semiconduttori. Fisica dei principali dispositivi a semiconduttore: diodo pn, BJT, MOSFET, giunzione Schottky. Fondamenti di chimica organica ed inorganica.

#### *Indicazioni metodologiche*

Metodo: lezioni frontali assistite da slides, esercitazioni frontali.

Attività:

- frequenza delle lezioni
- esercitazioni
- studio individuale
- risoluzione di problemi individuale.

La frequenza è consigliata.



## UNIVERSITÀ DI PISA

Programma (contenuti dell'insegnamento)

---

- Il processo CMOS
- Crescita di monocristalli, fabbricazione di wafer di silicio
- Ossidazione termica del silicio
- Drogaggio: diffusione termica, Impiantazione ionica
- Deposizione di film sottili: deposizione chimica da fase vapore (CVD), evaporazione, Sputtering
- Litografia UV ed a fascio elettronico
- Etching: wet etching, dry etching
- Integrazione di processo: ingegneria delle well e del canale, dielettrici ad alto  $k$ , tecnologie SOI, tecnologie MOS non planari
- Integrazione di processo: tecnologia delle interconnessioni (BEOL)
- Integrazione di processo: tecnologie MEMS
- Packaging

### Bibliografia e materiale didattico

1. Slide del corso
2. D. Plummer, M.D. Deal, P.D. Griffin: Silicon VLSI Technology: Fundamentals, Practice, and Modeling
3. S. Wolf, R.N. Tauber: Silicon Processing for the VLSI Era, Vol. 1: Process Technology

### Modalità d'esame

Esame finale orale (in genere 2-3 domande, durata indicativa di 30-45 minuti). Il voto finale è basato sull'esito dell'orale (peso: 100%).

*Ultimo aggiornamento 07/08/2019 14:59*